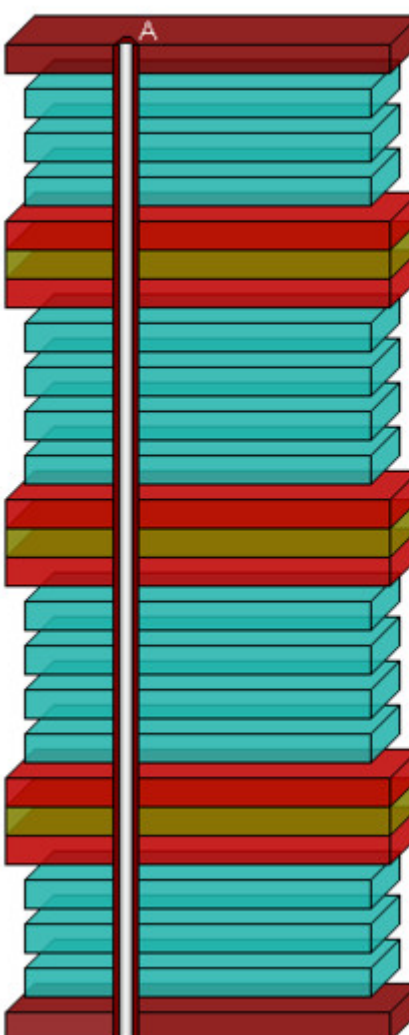


Lagenaufbau

Ebene		Komponente	Dicke (mm)	Cu (my)	Typ
1		Cu+galv.Cu		70+25	
		Prepreg	0.081		1080
		Prepreg	0.081		1080
		Prepreg	0.081		1080
2		Cu		105	
		Tr-Lam	0.51		
3		Cu		105	
		Prepreg	0.081		1080
		Prepreg	0.081		1080
		Prepreg	0.081		1080
		Prepreg	0.081		1080
4		Cu		105	
		Tr-Lam	0.51		
5		Cu		105	
		Prepreg	0.081		1080
		Prepreg	0.081		1080
		Prepreg	0.081		1080
		Prepreg	0.081		1080
6		Cu		105	
		Tr-Lam	0.51		
7		Cu		105	
		Prepreg	0.081		1080
		Prepreg	0.081		1080
		Prepreg	0.081		1080
8		Cu+galv.Cu		70+25	

Presslingsdicke* 3,12 +/- 10%

Gesamtdicke inkl. galv. Cu u. Lötstopmmaske* 3,23 +/- 10%

Bemerkungen zum Lagenaufbau:

- * Dickenberechnung mit Basismaterial FR-4 gefüllt bei 50% Kupferbelegung auf Innenlagen (abhängig von Basismaterialtyp, gewählter Kupferdicke und Kupferbelegung abweichende resultierende Isolations- und Enddicken)
- Dickentoleranz Basismaterial +/-10%
- minimale Kupferenddicken gemäß IPC 6012 aktuelle Ausgabe

Designrules zum Lagenaufbau

Durchgangslöcher [A] (Vias)	End-Ø	≥ 500 µm
	Viapad-Ø	≥ 950 µm
Leiterbild Außenlagen		
Standard	Leiterbreite bei 50 µm Grundkupfer	≥ 160 µm
	Leiterabstand bei 50 µm Grundkupfer	≥ 215 µm
	Leiterbreite bei 70 µm Grundkupfer	≥ 200 µm
	Leiterabstand bei 70 µm Grundkupfer	≥ 260 µm
Leiterbild Innenlagen	Leiterbreite bei 105 µm Grundkupfer	≥ 250 µm
	Leiterabstand bei 105 µm Grundkupfer	≥ 320 µm
	Leiterbreite bei 70 µm Grundkupfer	≥ 145 µm
	Leiterabstand bei 70 µm Grundkupfer	≥ 150 µm
Standard	Leiterbreite bei 105 µm Grundkupfer	≥ 175 µm
	Leiterabstand bei 105 µm Grundkupfer	≥ 190 µm